관계부처 합동	보 도 자 료	힘내라 대한민국
http://www.motie.go.kr		

2020년 9월 11일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 9.10.(목) 오후 2시부터 보도 가능)

배포일시	2020. 9. 10(목)	담당부서	산업부 과기정통부 과기정통부	반도체디스플레이과 원천기술과 인공지능산업팀
담당과장	조익노 과장(044-203-4270) 박진희 과장(044-202-4540) 장두원 팀장(044-202-6280)	담 당 자	김대영 사무관(044-203-4272) 전인수 사무관(044-202-4517) 임재현 사무관(044-202-6281)	

차세대지능형 반도체 1등 국가 도약을 위한 드림팀 출범

- 산업부·과기정통부 1조원 규모 기술개발 사업단 출범식 공동 개최 -

- 수요기업-개발기업 연대와 협력 등 2건의 양해각서(MOU) 체결 -

□ **산업통상자원부**(장관 성윤모, 이하 '산업부')와 **과학기술정보통신부**(장관 최기영, 이하 '과기정통부')는 9월 10일(목) 14시 반도체산업협회(경기 성남 판교 소재)에서 **'(재)차세대지능형반도체사업단 출범식'**과 함께 차세대 지능형 반도체의 성공적인 개발과 이를 뒷받침할 국내 반도체 선순환 생태계의 구축을 위한 **공공·민간의 역량을 결집하는 양해각서**(이하 'MOU'라 한다) **체결식을 개최**하였다고 밝혔다.

○ 이 날 출범식 행사에는 **성윤모 산업부 장관, 최기영 과기정통부 장관, 김형준 차세대지능형반도체 사업단장, SK 하이닉스 박성욱 부회장*, 국내 반도체 주요기업 및 협력기관**** 등 관계자 20여명이 참석하였다.

* 재단법인 차세대지능형반도체사업단 이사

** (수요·후원기업) 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 현대모비스, 삼천리, SK텔레콤, 한화테크윈, (개발기업) 텔레칩스, 스카이칩스, 퓨리오사AI, 넥스트칩 (협력기관) 나노종합기술원, 융합혁신지원단, 반도체협회 등

□ **차세대지능형반도체사업단(이하 '사업단')**은 산업부와 과기정통부가 올해부터 함께 착수하는 '차세대지능형반도체기술개발사업'의 성공적인 추진을 위한 구심점 역할을 할 수 있도록 단일 법인으로 구성된 기관으로,

○ 사업기간 동안 ①사업 기획 뿐만 아니라, 반도체 소자/설계/제조장비 등 반도체 산업 전 분야를 아우르는 **중장기 발전 로드맵**을 수립하고, ②이를 지원할 인프라 기관과의 유기적인 연계를 촉진할 뿐만 아니라, **공공-민간 협력의 가교 역할**을 담당하게 될 예정이다.

○ 차세대지능형 반도체 기술개발사업은 **10년간('20-'29) 총사업비 1조 96억원**이 투입되는 사업으로, **금년에는 103개 기업, 32개 대학, 12개 연구소**가 **82개 과제**에 참여하게 된다.

<차세대지능형 반도체 기술개발사업 개요>

◇ **(목표) 미래 수요대응, 신시장 선점을 위한 차세대 지능형 반도체 핵심·원천기술 확보**

◇ **(기간·금액) 산업부** 5,216**억원('20~'26), 과기정통부** 4,880**억원('20~'29) 총 1조 96억원**

* 최근 5년간 R&D 예타 사업 중 1조원 규모를 넘은 사업은 동 사업이 유일

◇ **(주요내용)** 전력소모 감소 및 고성능 구현을 위한 **미래소자**(과기정통부), 연산속도 향상을 위한 **설계기술**(과기정통부·산업부), 미세화 한계를 극복하는 원자단위 **공정·장비** 기술(산업부) 등

□ 또한, 이날 출범식의 부대행사로, 향후 우리나라가 차세대 지능형 반도체 글로벌 리더로서의 초석을 다지기 위한 ①'**반도체 소재·부품·장비 분야 경쟁력 제고를 위한 협력 MOU**와, ②'**반도체 주요기업-기관 간 연대와 협력 MOU**' 등 두 건의 협력 양해각서를 체결하였다.

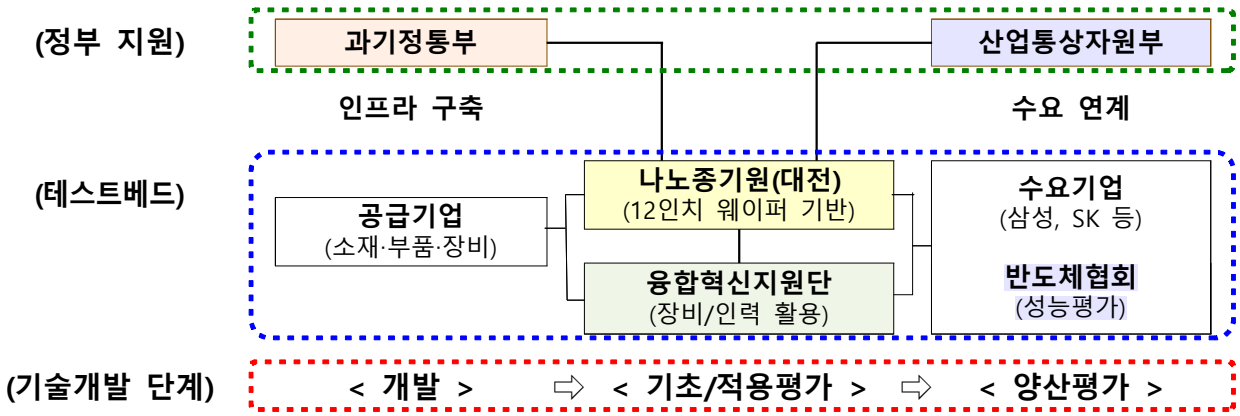
○ 먼저, 국내 반도체 소재·부품·장비 산업 경쟁력 강화를 원활하게 추진하기 위해 핵심기관間 MOU를 체결하였는데,

- **산업부**와 **과기정통부**는 반도체 소재·부품·장비 **기술개발**, 관련 **기업애로 해소** 및 **제도 개선**을 적극 지원하고

- 반도체산업협회, 나노종합기술원, 융합혁신지원단은 개발된 소재·부품·장비가 사업화에 성공할 수 있도록 **기업수요를 반영한 인프라 구축, 기초·적용평가와 양산평가 간 연계, 패턴웨이퍼 지원사업 관련 협력** 등을 적극 추진하기로 하였다.

- 이를 통해 **개발된 소재·부품·장비의 상용화 및 사업화 확대**로 **소재·부품·장비의 공급 안정성 확대에 기여**할 것으로 기대된다.

< 반도체 소재부품장비 협력 MOU 개요 >



○ 이어서, 차세대지능형반도체 기술개발사업의 성공을 위해 **수요-후원-개발기업과 협력기관이 참여하는 연대와 협력 MOU**를 체결하였는데,

- **수요-후원-개발기업**은 제품개발 초기에 필요한 **성능(spec)**에 대한 **정보 공유** 등 공동연구, 설계 검증을 위한 **파운드리 분야 서비스 제공** 등에 상호 협력하고,

- **협력기관**은 개발된 제품의 상용화를 위해 **시제품 제작, 분석·평가, 설계·검증 인프라** 등을 적극 지원하기로 하였다.

<반도체 주요 기업-기관 연대와 협력 MOU 주요내용>

구분	MOU 참여기관명	협력내용
수요기업	현대모비스,삼천리, SK텔레콤*, 한화테크윈,	▸ 개발초기단계에서 요구되는 성능(spec) 등을 개발기업과 공유하는 등 공동연구 협력
후원기업	삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍	▸ 소재부품장비 관련 수요기업으로서의 협력 + 팹리스 설계 검증 관련 파운드리 분야 협력
개발기업	텔레칩스, 스카이칩스, 퓨리오사AI, 넥스트칩	▸ 수요기업 등과의 협력을 통해 세계 최고 기술 개발에 전념
협력기관	나노인프라협의체 한국반도체산업협회	▸ (나노팹)집적 공정, 시제품 제작, 분석·평가 ▸ (협회)설계·검증 인프라 지원(시스템반도체 설계지원센터)

* SK텔레콤은 통신 분야 대표 수요기업이자 서버용 AI 반도체 개발 기업

<참고 : 기술 개발기업-수요기업간 협력 과제 예시>

적용분야	기술개발 적용 이미지(예)	협력 내용
자율차용 AI 반도체		◇ (용도) 운전자의 주행 습관을 인지·판단하여 안전주행을 보조하는 자율차용 AI 반도체 * (협력) 개발기업은 NPU 등 미래차용 AI반도체를 개발하고 수요기업의 자율차용 안전주행보조용 시스템에 적용·실증 * (주체) : 가온칩스, 텔레칩스 ↔ 현대모비스
가스 누설감지 시스템 반도체		◇ (용도) 매설된 가스배관의 가스 누설 감지용 시스템반도체 * (협력) 개발기업은 안전관리용 시스템반도체를 개발하고 수요기업의 안전관리 모니터링 시스템에 적용·실증 * (주체) : 로그프레트코리아, 스카이칩스 ↔ ㈜삼천리
서버용 AI반도체		◇ (용도) 클라우드 데이터센터 등 고성능 AI 인프라(서버)에 활용 가능한 서버용 AI 반도체 * (협력) 개발기업은 학습·추론이 가능한 서버용 AI 반도체(NPU)를 개발하고, 수요기업의 데이터센터 등에 적용·실증 * (주체) SK텔레콤, 퓨리오사AI ↔ SK텔레콤 ※ SK텔레콤은 구글(美)과 같이 AI 반도체 개발·수요기업 역할
IoT용 AI반도체		◇ (용도) 지능형 CCTV 등 영상보안기기에 활용 가능한 IoT용 AI 반도체 * (협력) 개발기업은 IoT 기기에 활용 가능한 AI 반도체(NPU)를 개발하고 수요기업의 지능형 CCTV 제품 등에 적용·실증 * (주체) : 넥스트칩 ↔ 한화테크윈

□ 출범식에서 **산업부 성윤모 장관은 "시스템반도체**는 **우리 미래 먹거리를 책임질 3대 신산업(Big3) 중 하나**로 시스템반도체 산업 육성을 통한 종합반도체 강국 도약을 위해 지난해 「**시스템반도체 비전과 전략**」('19.4.30)**을 마련하여 현재까지 차질없이 추진중**에 있다"고 언급하면서

○ "**시스템반도체 생태계 전반의 경쟁력 강화**를 위해 **융합얼라이언스 2.0을 확대 개편**해 인공지능 반도체를 중심으로 **설계기업-파운드리-수요기업간 연대와 협력을 제고**하고, 이를 뒷받침할 **소재·장비산업 등 생태계 경쟁력 강화**를 위해서도 **전방위적인 지원**을 아끼지 않겠다" 고 밝혔다.

□ 과기정통부 최기영장관은 "메모리 강국을 넘어 **종합반도체 강국**으로의 도약이라는 큰 목표를 달성하기 위해 오늘 출범한 **사업단**이 **구심점**이 되어 많은 역할을 해주기를 당부한다"면서,

○ "과기정통부는 **D.N.A 혁신성장**과 **디지털 뉴딜**과 연계하여 **AI 반도체를 선제적으로 도입, 확산**함으로써 **초기 시장을 창출**하고, **산업부 등과 긴밀히 협력**하여 **세계 최고의 AI 반도체 생태계**가 **조기에 구축**될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

□ 또한, 양 장관은 한 목소리로 "오늘 이 자리가 **반도체 분야 산·학·연이 연대와 협력을 강화**하여 **우리나라가 반도체 종합강국으로 도약**하는 계기가 되는 **중요한 전환점**(Turning Point)이 되기를 **기대**한다" 고 강조하였다.

□ 한편, 김형준 신임 사업단장은 **사업단 비전 및 운영계획**을 발표하면서 "코로나19상황에도 불구하고 차세대지능형반도체사업단에 많은 관심을 보여주는 만큼 산학연이 합심하여 **차세대지능형반도체 원천-상용화 기술개발을 통한 No. 1 반도체 강국으로 도약하는 기틀을 만들겠다"**라고 강한 의지를 밝혔다.

※ 수도권에 적용중인 2.5단계 사회적 거리두기에 따른 방역지침을 준수하여 행사를 개최하였음

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 김대영 사무관(☎ 044-203-4272), 과학기술정보통신부 원천기술과 전인수 사무관(044-202-4517), 인공지능산업팀 임재현 사무관(044-202-6281)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 **「차세대지능형반도체 사업단」 출범식 개요**

1. 행사개요

□ 일시/장소 : '20. 9. 10(목) 14시* / 차세대지능형반도체사업단 사무실**

* '경기도 성남시(판교) 소재 '반도체산업협회' 건물 內 7층 및 9층 입주

□ 참석자 : 산업부·과기정통부 장관, 김형준 사업단장, 박성욱 SK하이닉스 부회장 등 임원, MOU 체결대상 기관* 관계자

* 반도체협회, 나노종기원, 소부장 융합혁신지원단(32개 공공연 협의체), 과제 참여기업, 수요기업 등

□ 주요내용 : ①현판 제막식, ②사업단 비전 및 운영계획 발표, ③반도체 생태계 경쟁력 강화 협력 MOU 2건* 체결, ④사업단 창립이사회

* ① 반도체 소부장 경쟁력 강화 MOU, ②반도체 대표기업 연대와 협력 MOU

2. 세부일정(안) ※ 축하말씀까지만 공개

구분	시 간		세 부 일 정	비고
	14:15~14:25	10	■ **현판 제막식** - 양부처 장관, 김형준 사업단장, 박성욱 부회장, 연구재단·IITP·산기평 원장, 반도체협회장 등 8명	반도체협회 9층
출범식	14:25~14:30	'5	■ 출범식 개회	반도체협회 9층 대강당
	14:30~14:40	'10	■ **축하말씀** - 양 장관 각 5분(과기정통부→산업부)	
	14:40~14:50	'10	■ **사업단 비전선포 등 운영계획 발표**	사업단장
	14:50~15:00	'10	■ **MOU 체결** * ①반도체 소부장 경쟁력 강화 MOU ②동반성장을 위한 연대와 협력 MOU	
	15:00~15:10	'10	■ **기념 촬영**	

※ (14시～14시 15분) 제막식 참석자 사전 환담